2021年3月期 第3四半期決算短信(日本基準)(連結)

2021年2月8日

上場会社名 株式会社 メイコー

上場取引所

TEL 0467-76-6001

東

コード番号 6787

URL https://www.meiko-elec.com

代表者 (役職名)代表取締役社長

(氏名) 名屋 佑一郎

問合せ先責任者 (役職名) 経理本部長

(氏名) 本多 正行

四半期報告書提出予定日 2021年2月12日

配当支払開始予定日

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有 四半期決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 2021年3月期第3四半期の連結業績(2020年4月1日~2020年12月31日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する四 半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2021年3月期第3四半期	85,687	4.6	4,141	16.5	1,887	61.1	1,267	68.6
2020年3月期第3四半期	89,814	1.9	4,962	39.9	4,852	41.5	4,037	40.4

(注)包括利益 2021年3月期第3四半期 1,048百万円 (47.1%) 2020年3月期第3四半期 1,981百万円 (66.5%)

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期 純利益
	円銭	円 銭
2021年3月期第3四半期	48.42	
2020年3月期第3四半期	154.25	

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
2021年3月期第3四半期	136,857	33,377	24.3
2020年3月期	129,237	32,482	25.0

(参考)自己資本

2021年3月期第3四半期 33,214百万円

2020年3月期 32,288百万円

2. 配当の状況

	年間配当金						
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計		
	円銭	円銭	円 銭	円銭	円 銭		
2020年3月期		15.00		15.00	30.00		
2021年3月期		0.00					
2021年3月期(予想)				20.00	20.00		

(注)直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 2021年 3月期の連結業績予想(2020年 4月 1日~2021年 3月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上	高	営業和	削益	経常和	削益	親会社株主I 当期純		1株当たり当期 純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円銭
通期	116,000	0.5	5,300	2.1	3,500	26.9	2,700	4.4	103.16

(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 有

(注) 詳細は、添付資料7ページ「2.四半期連結財務諸表及び主な注記(3)四半期連結財務諸表に関する注記事項(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)」をご覧ください。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無 以外の会計方針の変更 : 無 会計上の見積りの変更 : 無 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

期末発行済株式数(自己株式を含む)

期末自己株式数

期中平均株式数(四半期累計)

2021年3月期3Q	26,803,320 株	2020年3月期	26,803,320 株
2021年3月期3Q	629,506 株	2020年3月期	629,427 株
2021年3月期3Q	26,173,881 株	2020年3月期3Q	26,173,894 株

四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

(将来に関する記述等についてのご注意)

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大き〈異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料2ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報(3)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

○添付資料の目次

1.当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	2
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	S
(1) 四半期連結貸借対照表	S
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	5
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	7
(継続企業の前提に関する注記)	7
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	7
(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)	7
(セグメント情報等)	7

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1)経営成績に関する説明

当第3四半期連結累計期間における電子部品業界は、新型コロナウイルス感染拡大の影響による景気の低迷から 脱却し、徐々に回復基調となりましたが、一方で新型コロナウイルス感染症は再拡大しており、先行きの不透明感 は継続しております。

このような状況の中、当社グループでは、受注面は第2四半期に回復基調に転じ、当第3四半期も好調を維持しました。販売面では、上期の低迷の影響を受け当第3四半期連結累計期間では前年同期比で減収となりましたが、四半期売上としては過去最大となりました。用途別では、車載向け基板は、世界的な自動車生産の回復と電動化・電装化が進行しました。スマートフォン向け基板は、5G関連製品の比率の向上が顕著になりました。IoT/AI家電向け基板、アミューズメント向け基板とEMS事業も好調を維持しました。収益面では、引き続き全社的なコスト削減策を推進しておりますが、銅や金などの資源価格の高騰や、円高と中国人民元高の為替影響を受けました。

以上の結果、当第3四半期連結累計期間の売上高は、85,687百万円(前年同期比4.6%減)と前年同期に比べ 4,126百万円の減収となりました。損益面では、営業利益が4,141百万円(前年同期比16.5%減)、経常利益が 1,887百万円(前年同期比61.1%減)、親会社株主に帰属する四半期純利益が1,267百万円(前年同期比68.6%減) となりました。

(2) 財政状態に関する説明

(資産)

当第3四半期連結会計期間末の総資産は136,857百万円となり、前連結会計年度末に比べ7,620百万円増加しました。流動資産において、受取手形及び売掛金が4,556百万円増加、たな卸資産が1,313百万円増加、固定資産において、有形固定資産が1,657百万円増加が主な要因であります。

(負債)

当第3四半期連結会計期間末の負債は103,480百万円となり、前連結会計年度末に比べ6,724百万円増加しました。流動負債において、支払手形及び買掛金が2,221百万円増加、短期借入金が6,617百万円増加、1年内返済予定の長期借入金が2,795百万円減少、固定負債において、長期借入金が703百万円増加が主な要因であります。

(純資産)

当第3四半期連結会計期間末の純資産は33,377百万円となり、前連結会計年度末に比べ895百万円増加しました。利益剰余金が1,114百万円増加、為替換算調整勘定が378百万円減少が主な要因であります。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2021年3月期の連結業績予想につきましては、2020年11月6日に公表いたしました連結業績予想から変更はありません。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2020年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	13, 889	13, 928
受取手形及び売掛金	24, 448	29, 004
商品及び製品	5, 148	5, 866
仕掛品	5, 505	5, 980
原材料及び貯蔵品	8, 302	8, 423
その他	2, 558	2, 585
貸倒引当金	△135	△138
流動資産合計	59, 716	65, 650
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	23, 205	22, 460
機械装置及び運搬具(純額)	29, 175	30, 126
土地	1, 488	1, 488
建設仮勘定	4, 909	6, 869
その他(純額)	4, 218	3, 708
有形固定資産合計	62, 997	64, 654
無形固定資産	827	885
投資その他の資産	5, 696	5, 668
固定資産合計	69, 520	71, 207
資産合計	129, 237	136, 857

(単位:百万円)

	(単位:日 <i>刀円)</i>				
	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2020年12月31日)			
負債の部					
流動負債					
支払手形及び買掛金	17, 732	19, 953			
短期借入金	9, 686	16, 303			
1年内返済予定の長期借入金	15, 544	12, 749			
未払法人税等	204	158			
賞与引当金	687	487			
役員賞与引当金	40	_			
その他	8, 169	8, 654			
流動負債合計	52, 064	58, 306			
固定負債					
長期借入金	40, 478	41, 182			
役員退職慰労引当金	217	215			
退職給付に係る負債	2, 696	2, 711			
その他	1, 298	1,063			
固定負債合計	44, 691	45, 173			
負債合計	96, 755	103, 480			
純資産の部					
株主資本					
資本金	12, 888	12, 888			
資本剰余金	6, 464	6, 464			
利益剰余金	13, 159	14, 274			
自己株式	△396	△396			
株主資本合計	32, 116	33, 231			
その他の包括利益累計額					
その他有価証券評価差額金	△8	0			
繰延ヘッジ損益	30	182			
為替換算調整勘定	375	$\triangle 2$			
退職給付に係る調整累計額	△224	△196			
その他の包括利益累計額合計	172	△16			
非支配株主持分	193	162			
純資産合計	32, 482	33, 377			
負債純資産合計	129, 237	136, 857			

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第3四半期連結累計期間

		(単位:百万円)
	前第3四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年12月31日)
売上高	89, 814	85, 687
売上原価	76, 037	73, 847
売上総利益	13, 777	11, 840
販売費及び一般管理費	8,814	7, 698
営業利益	4, 962	4, 141
営業外収益		
受取利息	67	41
受取配当金	5	4
助成金収入	175	431
為替差益	53	<u> </u>
その他	364	205
営業外収益合計	665	683
営業外費用		
支払利息	525	471
シンジケートローン手数料	24	620
為替差損	_	1, 756
その他	225	89
営業外費用合計	775	2, 937
経常利益	4, 852	1, 887
特別利益		
固定資産売却益	0	2
投資有価証券売却益	3	_
投資有価証券評価損戻入益	327	_
特別利益合計	330	2
特別損失		
固定資産除売却損	131	70
災害による損失	_	29
投資有価証券売却損	0	_
事業構造改善費用	210	304
貸倒引当金繰入額	_	0
特別損失合計	341	405
税金等調整前四半期純利益	4, 841	1, 484
法人税等	794	239
四半期純利益	4, 046	1, 245
非支配株主に帰属する四半期純利益又は 非支配株主に帰属する四半期純損失(△)	9	△21
親会社株主に帰属する四半期純利益	4, 037	1, 267

四半期連結包括利益計算書 第3四半期連結累計期間

		(単位:百万円)_
	前第3四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年12月31日)
四半期純利益	4, 046	1, 245
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	33	9
繰延ヘッジ損益	△110	152
為替換算調整勘定	△2, 021	△387
退職給付に係る調整額	33	28
その他の包括利益合計	<u></u> △2, 065	△197
四半期包括利益	1,981	1, 048
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	1, 968	1,079
非支配株主に係る四半期包括利益	13	△30

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) 該当事項はありません。

(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)

(税金費用の計算)

税金費用については、当第3四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計 適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社グループは、電子回路基板等の設計、製造販売及びこれらの付随業務の電子関連事業を主とし、その他の事業については、重要性が乏しいため、記載を省略しております。